

INKJET PRINTER

SUSS JETx 平台

用于电子制造的大规模生产喷墨打印机





INKJET PRINTER

SUSS JETx

适用于各种应用的生产型打印机

JETx量产喷墨打印机是SUSS MicroTec最先进的功能材料打印平台。它采用模块化架构，可根据需求配置用于多种应用，如印刷电子、光伏、PCB阻焊、半导体封装和化学加工。JETx设计为24/7全自动生产，并且通常配置为处理客户大量特定产品。JETx系统采用花岗岩基座，以确保卓越的稳定性、极高的平台精度和打印精度，同时结合高吞吐量和最低的拥有成本。它基于三个标准平台：JETx-P、-S和SM，每个系统都针对特定的应用领域和产品尺寸。

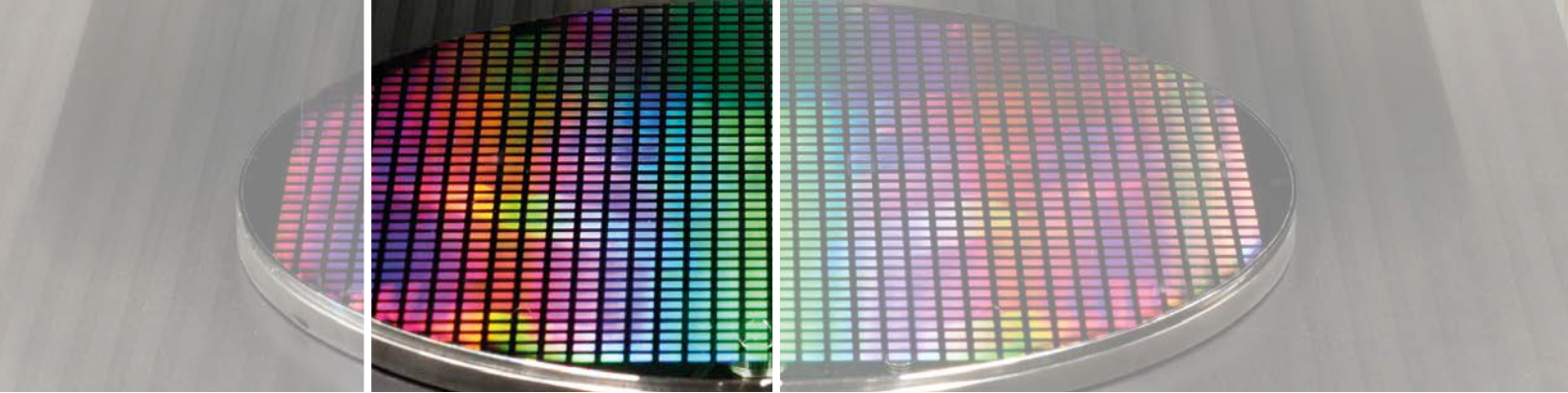


SUSS JETx 亮点

- + 可批量生产功能材料的喷墨打印机
- + 可配置设计, 适用于各种应用
- + 精确的运动系统
- + 拥有成本低
- + 高生产率

实现未来技术 喷墨应用实例

印刷电路板 (PCB)	半导体	印刷电子 (PE)	其他
阻焊层	钝化层	金属化	医药
阻焊坝	光刻胶	封装	微蚀刻
蚀刻掩膜	引线框架涂层	多层结构	传感器激活



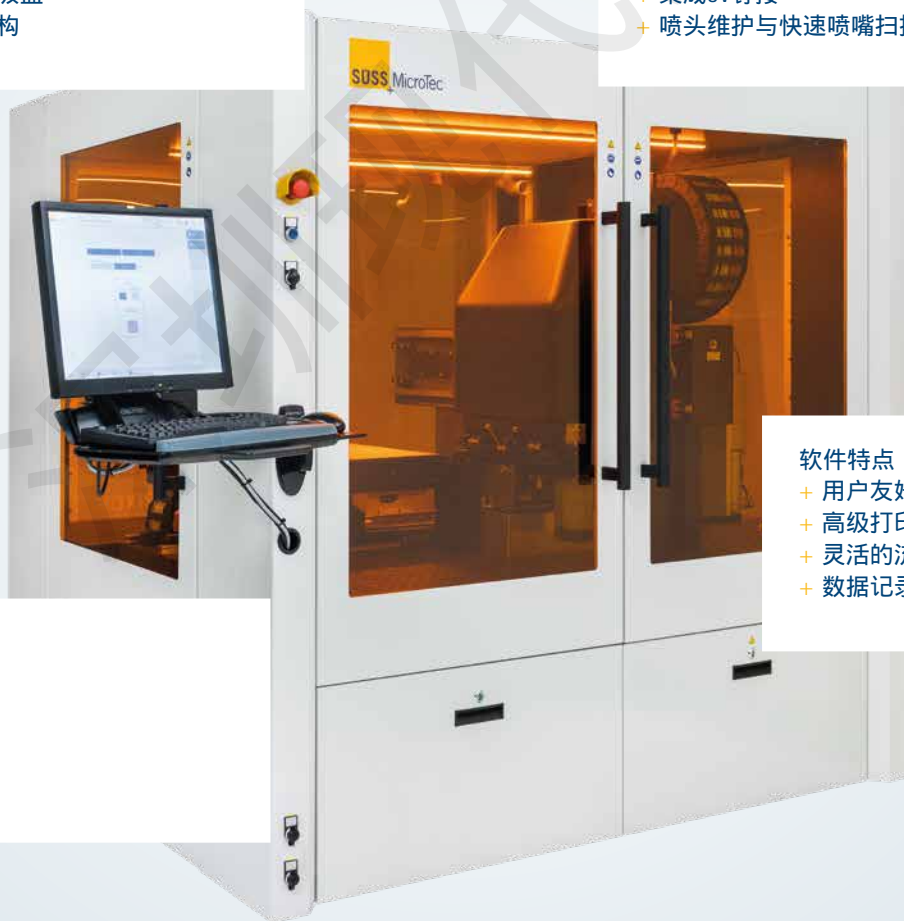
多功能喷墨打印平台 主要特点

基础平台

- + 占地面积小，底座框架稳固
- + 花岗岩和金属为基础的运动系统
- + 针对各种基材的定制真空吸盘
- + 惰性气体和洁净室封闭结构

打印引擎

- + 打印头配置可选
- + 多种、循环和散装油墨供应
- + 集成UV钉接
- + 喷头维护与快速喷嘴扫描



辅助功能

- + 先进的基板对齐
- + 自动化基板处理
- + UV/红外线 (NIR) 固化
- + 基板识别与打印检查
- + 工厂自动化与集成

软件特点

- + 用户友好的人机界面 (HMI)
- + 高级打印策略
- + 灵活的流程编辑器
- + 数据记录与MES 接口



SUSS JETx 技术规格

	JETx-P	JETx-S	JETxSM
最大基板尺寸	150x150mm	300x400mm	610x762mm (24x30英寸)
最大基板厚度	10mm	20mm	10mm
基板夹具	真空	真空	真空 (可选机械辅助)
基座框架	钢材	花岗岩	花岗岩
平台精度	± 15µm (3σ)	± 3µm (3σ)	± 5µm (3σ)
平台精确度	± 3µm (3σ)	± 1µm (3σ)	± 2µm (3σ)
运动轨道	X, Y, Z, Rz	X, Y, Z, Rz	X, Y, Z (Rz 可选)
打印速度	达到1000mm/s		
打印头	每个头128-2048 喷嘴; 液滴容量2-80pL		
打印头更换时间	< 15分钟, 自动校准		
维护 (可选)	快速喷嘴扫描, 清洗, 吸出, 擦拭		
视角系统(可选)	液滴观测, 打印图像观测, 图案检测		
用户界面	直观的触摸屏 (符合 SEMI E10标准)		
图像格式	Gerber, TIFF, postscript, PDF, 动态处理格式 (DPF), ODB++, Bitmap		
油墨类型	溶剂型, 纳米粒子型, 水型, 热熔型, UV固化型		
油墨粘度	2-20cP		
油墨供应	使用大容量油墨罐 (静态或循环)实现不间断供应		
集成后处理	UV钉固, UV 固化, 红外线 (NIR) 固化		
占地面积 (W x D x H)	视配置而定	1.2x1.7x2.0m	1.5x2.0x2.0m
重量 (独立设备)	1.2-1.8t	1.2t	1.8t

数据、设计和规格取决于各个工艺条件，并可能因设备配置而有所不同。并非所有规格都能同时适用。

本手册中的插图、照片和规格不具有法律约束力。

SUSS MicroTec保留在不事先通知的情况下更改机器规格的权利。



SUSS JETx 主要特点

Inkjet 打印机型号	应用和关键特性	最大基板尺寸
JETxSM	PCB(印刷电路板), 显示屏, 印刷, 化学加工 高精度 ($\pm 5\mu\text{m}$)	610 x 762 mm (24 x 30 inch)
JETx-S	半导体, 印刷电子 非常高精度 ($\pm 3\mu\text{m}$)	300 x 400 mm
JETx-P	光伏 极高的吞吐量 (每小时1200片晶圆)	6 inch square

JETxSM



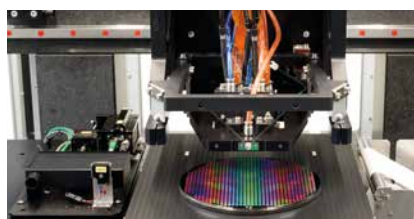
应用:
PCB上的阻焊层, 面板上的蚀刻掩膜, 封装层

吞吐量:
每小时最多可处理60面

特征尺寸:
小至75/75 μm Line/Space

涂层厚度:
5-100 μm

JETx-S



应用:
用于半导体后端和封装的介电材料、导电材料、粘合剂、遮蔽阻挡层材料

吞吐量:
每小时最多可处理120基材

特征尺寸:
小至40 μm

涂层厚度:
0.5-100 μm

JETx-P



应用:
太阳能晶圆上的遮蔽层

吞吐量:
每小时最多可处理1200 晶圆

特征尺寸:
小至20 μm

晶片破损率:
<0.01 %